

# 中山华利实业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

**特别提示**  
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2021年4月15日(T+2日)及时履行缴款义务：  
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年4月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。  
网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构(主承销商)”)包销。  
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配

售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。  
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。  
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。  
根据《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月14日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了中山华利实业集团股份有

限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	4262,9362
末“5”位数	53592,08592,33592,58592
末“6”位数	952651,152651,352651,552651,752651,817202,317202
末“7”位数	7176319,9176319,1176319,3176319,5176319,252898,752898
末“8”位数	2185920,4185920,6185920,8185920,0185920,16941191,66941191,8388724,5697833
末“9”位数	000248797

凡参与本次网上定价发行申购中山华利实业集团股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,均为中签号码。中签号码共有65,520个,每个中签号码只能认购500股中山华利实业集团股份有限公司A股股票。

发行人:中山华利实业集团股份有限公司  
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司  
2021年4月15日

# 中山华利实业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

**特别提示**  
中山华利实业集团股份有限公司(以下简称“华利集团”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请(经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可(2021)743号)。  
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。  
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为11,700万股,本次发行价格为人民币33.22元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,最终战略配售数量为3,510万股,约占本次发行数量的30%,初始战略配售与最终战略配售股数相同。

认购数量的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。  
网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。  
2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。  
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。  
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。  
战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为鑫众华利1号资管计划和鑫众华利2号资管计划,其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。  
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。  
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。  
5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。  
网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,552万股,占扣除战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为1,638万股,占扣除战略配售数量后发行数量的20%。根据《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,071.35倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将1,638万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,914万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为3,276万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0247789878%。  
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年4月15日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

网下投资者应根据《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年4月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴

1、网下投资者应根据《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年4月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴

## 财达证券股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

财达证券股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过500,000,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1017号文核准。  
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行的。本次发行规模为500,000,000股,其中网下初始发行数量为350,000,000.00股,占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为150,000,000.00股,占本次发行数量的30.00%。  
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2021年4月16日举行网上路演,敬请广大投资者关注。  
一、网上路演网址:中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com>)、上证路

演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)。  
二、网上路演时间:2021年4月16日(周五)9:00-12:00。  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)相关人員。  
《财达证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2021年4月9日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:财达证券股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2021年4月15日

## 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构(联席主承销商):国信证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“瑞华泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)841号文注册通过。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、(国信证券、中信建投证券统称“联席主承销商”)。  
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。  
本次发行数量4,500万股,初始战略配售预计发行数量为675万股,占本次发行总数量的15%。网下初始发行数量为2,677.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为1,147.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行

数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。  
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。  
1、网上路演时间:2021年4月16日(周五)9:00-12:00。  
2、网上路演网址:上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>  
中国证劵网:<http://roadshow.cnstock.com>  
3、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。  
本次发行的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

发行人:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):国信证券股份有限公司  
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司  
2021年4月15日

## 深圳新益昌科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“新益昌”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,553.36万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)928号文同意注册。  
本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”),采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。  
发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。  
本次拟公开发行新股2,553.36万股,占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为127.6680万股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,697.9920万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为727.7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为

本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。  
1、网上路演时间:2021年4月16日(T-1日)9:00-12:00  
2、网上路演网址:  
上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)  
中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com>)  
中证网(<http://www.cs.com.cn>)  
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。  
本次发行的《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:深圳新益昌科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司  
2021年4月15日

## 深圳市正弦电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,150万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,于2021年3月16日经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)842号文同意注册。  
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。  
发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股2,150万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为322.50万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为1,279.25万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为548.25万股,占扣除初始战略配售数量后发行数

量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。  
1、网上路演时间:2021年4月16日(T-1日)14:00-17:00  
2、网上路演网址:上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>  
中国证券网:<http://roadshow.cnstock.com>  
中国证劵网:<http://roadshow.cnstock.com>  
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。  
本次发行的《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市正弦电气股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司  
2021年4月15日

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告

证劵代码:002213 证劵简称:大为股份 公告编号:2021-036  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市芯汇微电子技术有限公(以下简称“芯汇微”)于近日收到国家知识产权局颁发的96项《实用新型专利证书》,具体情况如下:  
(一)实用新型名称:一种便于调节的集成电路测试用承载治具  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0015803.3  
3.专利申请日:2020年1月6日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年10月9日  
6.专利期限:十年(自申请日起算)  
(二)实用新型名称:一种高散微热集成电路  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0322306.5  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年10月27日  
6.专利期限:十年(自申请日起算)  
(三)实用新型名称:一种具有储能功能的可移动式小型服务器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0322305.5  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年10月27日  
6.专利期限:十年(自申请日起算)  
(四)实用新型名称:一种集成电路测试分选机

1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0020607.7  
3.专利申请日:2020年1月31日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月24日  
(六)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年1月7日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(七)实用新型名称:一种便于调节的半导体测试装置  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(八)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(九)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十一)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十二)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十三)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十四)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十五)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十六)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十七)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十八)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(十九)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十一)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十二)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十三)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十四)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十五)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十六)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十七)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十八)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(二十九)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十一)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十二)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十三)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十四)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十五)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十六)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十七)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十八)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(三十九)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十一)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十二)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十三)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十四)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十五)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十六)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十七)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十八)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(四十九)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(五十)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(五十一)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(五十二)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(五十三)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(五十四)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(五十五)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月16日  
4.专利权人:深圳市芯汇微微电子技术有限公司  
5.授权公告日:2020年11月27日  
(五十六)实用新型名称:一种自主散热的集成电路IC连接器  
1.发明人:柯武生;王桂桂;黄崇城;张进国  
2.专利号:ZL 2020 2 0023859.X  
3.专利申请日:2020年3月